

证券代码：301095

证券简称：广立微

# 杭州广立微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-004

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 线上交流 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
活动参与人员	华夏基金、广发基金、信达澳亚、南方基金、长信基金、华商基金、中信建投、湖南源乘投资管理有限公司、海通证券、鹏扬基金、第一创业、国金基金、嘉实基金、英大基金、石锋资产、汇丰晋信、光大保德信投资部、浦银安盛、信泰人寿保险、工银瑞信、上海中域投资有限公司、Willing Capital Management Limited、长城财富、上海懿坤资产管理有限公司、国新投资有限公司、中金公司、建信养老、华宝基金、富国基金、泰康资产、宏利基金、友邦人寿保险有限公司、江西彼得明奇资产管理有限公司、银华基金、睿郡资产、中泰证券、长城证券、中邮证券、财通证券、国盛电子、华泰保险、趣时资产、东方证券资管、东海基金、中海基金、九泰基金、兴银基金、华福证券、易方达基金、富荣基金、百年资管、太平洋资产、远信投资、重鼎资产、于翼资产、人保养老、光大资管、华泰柏瑞、国华兴益资管、国寿安保、太保资产、建信保险资管、弥远投资、招商基金、留仁资产、西部利得、趣时投资、野村资管、金信基金、金元顺安、鹤禧投资、浙商证券、上海国际信托、常春藤私募、中欧基金、中移资本、交银施罗德、博时基金、和谐汇一、天倚道投资、宝盈基金、永安财产保险、汇融创投、铭大实业、附加值投资、陆家嘴国泰人

	<p>寿、龙蟒集团、广发证券、银河基金、国泰基金、国联安基金、平安养老基金、长江养老基金、兴全基金、海富通基金、国盛证券、尚正基金、融通基金、生命保险资产、前海开源、泉果基金、华泰证券、天风证券、东方阿尔法基金共 104 家机构。</p>
时间	2024 年 8 月 23 日-2024 年 9 月 18 日
地点	现场交流、公司会议室
形式	现场会议、线上交流
公司接待人员	<p>董秘兼财务总监：陆春龙</p> <p>证券事务代表：李妍君</p>
交流内容及具体问答记录	<p><b>一、公司概况</b></p> <p>广立微是领先的集成电路 EDA 软件与晶圆级电性测试设备供应商，公司专注于芯片成品率提升和电性测试快速监控技术，是国内外多家大型集成电路制造与设计企业的重要合作伙伴。公司现已形成 EDA 设计软件、WAT 测试设备及半导体数据分析工具相结合的成品率提升全流程解决方案，在集成电路从设计到量产的整个产品周期内实现芯片性能、成品率、稳定性的提升。</p> <p><b>二、问答环节</b></p> <p><b>1、请公司对 2024 年上半年经营业绩做简要介绍？</b></p> <p>2024 年上半年，AI 及相关应用加速落地、新能源库存去化改善、电动汽车渗透率上升、工业应用走出低谷、消费电子持续复苏，在上述诸多因素驱动下全球半导体行业逐步回暖。公司根据行业发展趋势推出解决客户痛点的高性价比产品，持续发挥全流程良率提升的软硬件协同优势，为客户提供高附加价值的产品和方案，收入整体保持增长态势。</p> <p>2024 年上半年公司实现营业收入 17,177.59 万元，同比增长 34.86%，主要系软件开发及授权业务快速增长所致，其同比增长 86.81%；2024 年上半年公司剔除股份支付影响的归属于上市公司股东的净利润为 2,056.52 万元，盈利情况逐季度改善。上半年公</p>

司研发投入 13,204.08 万元，同比增长 41.77%，主要系公司产品线丰富，研发团队逐渐扩大。

## 2、请公司简要介绍下上半年的业务拓展亮点

公司根据行业发展趋势持续推出解决客户痛点的高性价比产品，发挥全流程良率提升的软硬件协同优势，为客户提供高附加价值的产品和方案，并进一步拓展应用场景和客群。

在 EDA 软件方面，公司近年来新推出了设计类 EDA 软件 DFT 工具，目前 DFT 设计和良率诊断解决方案整合完成，已在多家客户处应用并实现销售收入，技术表现达到标杆工具水平，获得良好的客户口碑；可制造性设计（DFM）工具核心模块研发取得重要进展，其中 CMPEXP 已在国内多家头部企业试用。

在大数据分析系统方面，公司持续拓展数据平台的深度与广度，今年上半年半导体人工智能应用平台 INF-AI 正式发布，且已被多家客户引入使用，以 AI/大模型赋能设计与制造；半导体离线大数据分析系统已完整布局并持续迭代升级，技术达国际领先水平，DE-YMS、DE-DMS 等产品取得规模订单；半导体在线大数据分析系统研发稳步推进，已在客户处迭代试用，助力集成电路实现高质量智能制造；半导体通用数据分析软件 DE-G 功能打磨成熟，性能指标已可替代国际通用统计分析软件，应用客群规模显著提升。

在测试设备方面，公司拓宽了产品品类，新推出的晶圆级 WLR 测试设备开始商务落地，成为公司业务多元化增长的新动能；此外，公司与合作机构协作完成了部分关键部件的研发，推出了采用新型高性能矩阵开关构架的 T4000 Max 机型。

## 3、公司 2024 年上半年研发投入增速仍较快，请简要介绍公司研发成果与方向？

为保障技术的先进性并巩固和提高公司技术壁垒，公司多年来始终保持高比例的研发投入，2024 年上半年公司研发投入 13,204.08 万元，占营业收入的 76.87%，同比增长 41.77%，研发

人员由年初的 416 人增长至 454 人。2024 年公司的主要研发成果包括：

第一，截止 6 月末，公司的授权专利数量达到 160 项，同比增长 37.93%，发明专利 88 项，同比增长 62.96%

第二，在 EDA 软件方向，我们研发了高效的工艺过程监控（PCM）方案，将我们成品率提升方案从工艺开发拓展到芯片量产环节；我们延伸布局可制造性 DFM 系列软件，降低芯片研发难度和制造成本；同时我们推出了可测试性（DFT）设计解决方案，这也标志着公司的软件产品从制造类 EDA 拓展到了设计类 EDA，成为上半年软件收入的增量之一。

第三，在数据软件方向，我们深入挖掘集成电路制造过程中的工艺和检测数据价值，已完成离线大数据分析系统的布局，并持续推进在线大数据分析和控制系统；另一方面，我们将人工智能技术、机器学习、大模型等技术运用在半导体数据分析领域，推出了 INF-AI 软件产品，取得了较好的市场反响。

第四，在电性测试设备方面，公司推出了可靠性（WLR）测试设备，也在布局高电压测试设备研发，并向上游延伸快速推进关键部件的协作研发，以实现供应链自主化。

未来，公司将持续加大研发投入，积极进行前瞻性技术布局，进一步巩固技术壁垒，形成新的业绩增长点。

#### **4、近期 EDA 行业并购频发，公司 2024 年是否会有并购的规划？**

上市公司并购是一种加快企业做大做强的重要手段，EDA 行业具有产品链长、工具品类繁多、技术门槛高等特点，纵观国际 EDA 龙头企业的发展史均是频繁的并购史，通过并购加快产品矩阵布局、整合提升企业的竞争力，成长壮大并发展成为业界顶尖企业。

公司将借鉴 EDA 产业界的成功经验，根据企业的总体战略规划，立足自身稳健发展的同时，积极关注与公司业务相关领域的发展情况，综合考虑内外部多方面因素，合理运用资本工具

	<p>加速公司成长和发展，助力公司不断提升综合实力和市场竞争力。同时，公司也将严格遵守相关法律法规的要求，当出现上述重大事项时及时向广大投资者披露。</p> <p><b>5、请公司简要介绍下境外市场的开拓情况</b></p> <p>广立微自成立以来尤其在早期业务开拓阶段，公司业务有较大比重来自于海外市场，近年来随着国内集成电路行业的快速发展，以及海外业务拓展受到相关政策的影响，导致公司收入结构中海外业务占比有所减少。近年来，公司为设备、软件的出海做了诸多布局和努力：1) 加强与既有的海外经销商合作，积极拓宽海外市场的覆盖广度；2) 公司设立了新加坡子公司、增资参股海外合作伙伴，进一步深入海外市场；3) 公司也在不断革新产品，以适应海外市场拓展的需要。由于 EDA 软件与电性测试设备等产品存在壁垒深厚、验证周期长等特点，现阶段海外市场占公司的收入比重仍较低，但随着市场拓展的深入和验证的推进，海外市场有望成为公司新的业绩增量。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>无。</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）</p>	<p>无。</p>
<p>日期</p>	<p>2024 年 9 月 18 日</p>